

DA 150 固晶导电胶 技术数据表

高电导率

优异的耐湿性能

高可靠性

简介

DA 150 是一种以银粉填充的高电导率、无溶剂、快速固化的热固性固晶导电胶。该材料对基板及裸芯片具有优异的附着力, 适用于小尺寸及大尺寸芯片的固晶应用。DA 150 可通过点胶或印刷方式施胶, 并已在高可靠性及高温回流焊工艺中表现出优异性能。

物理特性

产品名称	DA 150 导电胶
填料	银
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	3.5 g/cc
粘度 (ASTM D-1384)	5–15 kcp
固化材料特性	
玻璃化转变温度 Tg	118 °C
C.T. E (ASTM E 831), PPM/°C	32
导热系数 (W/mK)	2–5
杨氏模量(GPa)	2–3
体积电阻率(Ω·cm)	0.00001–0.0001

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na ⁺	< 5 ppm
K ⁺	<5 ppm
F ⁻	< 5 ppm
Cl ⁻	< 10 ppm
表面绝缘电阻(J-STD-004)	通过
芯片剪切强度	2x2毫米矽晶片(鍍鈀):2.0 2x2毫米鍍金矽晶片(裸銅基 底):2.5 2x2毫米鍍金矽晶片(鍍金基 底):2.3

推荐固化条件

150 °C × 30–60 分钟

注:上述固化时间不包括键合部位升温至设定固化温度所需时间。可根据客户需求评估其他固化工艺条件。

储存与保质期

在 -40 °C 条件下、原厂密封容器中保存, 保质期为 6 个月。

超过建议储存期限可能导致粘度上升。请避免受潮、挥发及外来杂质污染, 否则可能影响产品的加工性能。

安全

DA 150 为环保、无毒材料。操作时建议遵循一般工业卫生规范。详细安全信息请参阅 SDS (安全数据表)。

包装

DA 150導電膠提供10cc 30cc 包裝規格。其他包裝規格可依客戶需求客製。如需訂購, 請聯絡YINCAE公司。